



合肥工业大学硕士研究生 联合培养项目介绍

安徽安芯电子科技股份有限公司



1

PART1

Company profile

公司概况



集团公司架构



专业进取

客户至上

人尽其才

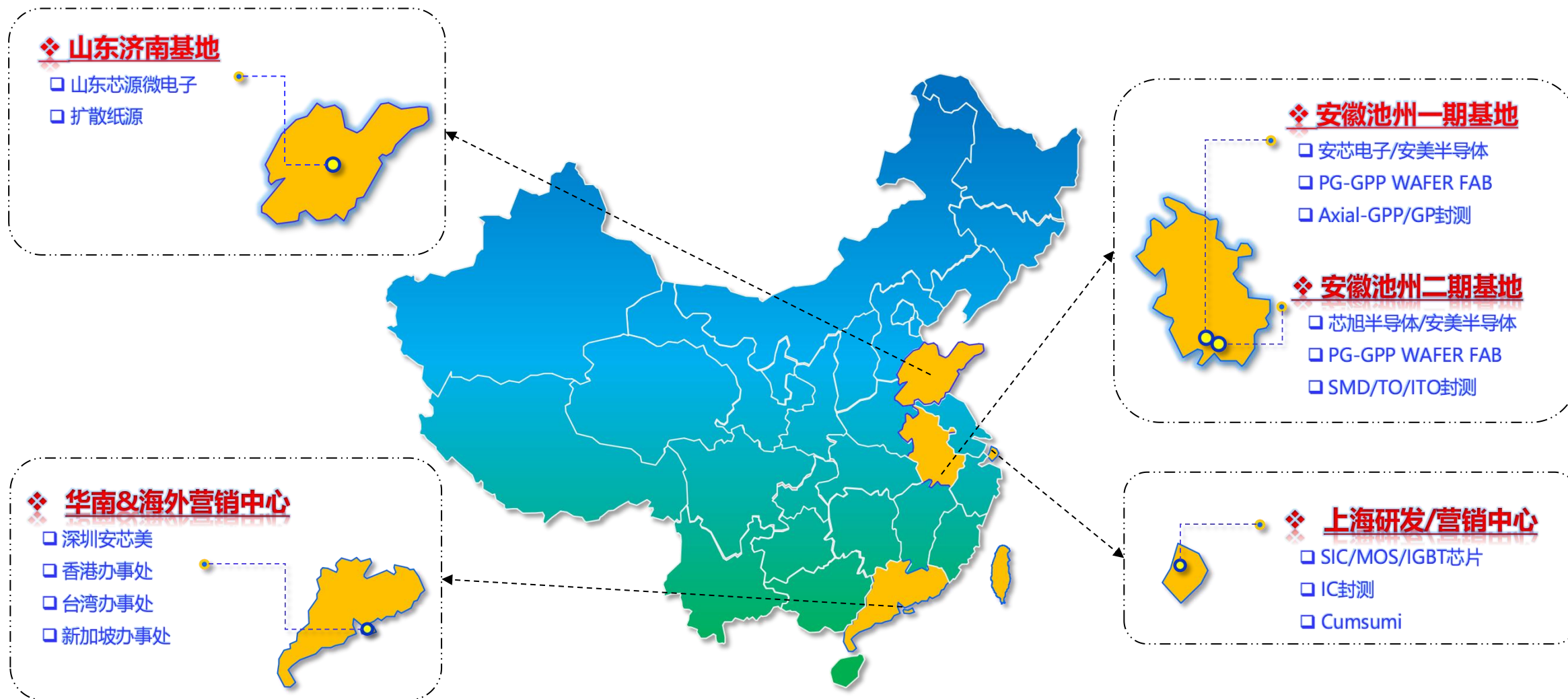
亲如一家



地理位置

Anxin

安徽安芯电子科技股份有限公司
Anhui Anxin Electronic Technology Co., Ltd.



专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



公司概况

- 占地面积 : 20,000平方米（一期基地）/ 50,000平方米（二期基地）
- 员工人数 : 1028人
- 注册资本 : RMB 50 Million
- 主要产品 : **GPP Wafer** : STD,FR,UF,SF(ASCUT&EPI),TVS
Assembly: Axial Diode, SMD, Power Pack(TO/ITO),Bridge
Diffusion Preform: Phosphorus paper,Boron paper
- 资质认证 : ISO9001/ IATF16949/ISO14001/IECQ-HSPM

一期基地



二期基地



专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



PART2

2

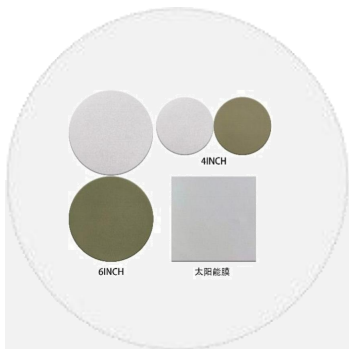
Core Advantage

核心竞争优势



全产业链 (IDM) 优势

产业链
类别



半导体材料



晶圆设计制造



封装测试



终端客户

优势

4寸/5寸/6寸膜
状磷硼扩散源、
中性纸源；
太阳能光伏专
用膜状扩散源

全球第二家膜状
扩散源厂商

4寸 / 5寸 GPP
4寸 / 5寸
TVS/Zener
4寸 SCR/TRIAC

自有晶圆设计开发
能力及供货保障

轴式二极管、
贴片二极管、
整流桥系列、
TO/ITO系列
SCR/TRIAC

自动化封测线
品质及交付保障

电源、 家电、
通信、 工控、
安防、 仪表、
汽车电子、 新能
源等全领域

稳定的战略
合作关系

专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



管理团队优势

- 1) 核心管理层在行业内知名外资企业产品研发/品质管理/生产运营工作经验;
- 2) 主要管理团队成员均为自主培养, 具备优秀的管理思维和执行能力。



Y2003

汪良恩先生带领技术团队在上海海湾电子 (Gulf) 成功设立了Photo Glass工艺GPP芯片生产线, 填补了Gulf在PG-GPP产品线上的空白。

Y2009

汪良恩先生领军的技术和管理团队在扬州 成功创建了杰利半导体 (扬杰旗下芯片子公司), 为扬杰 GPP芯片以及成品业务的快速拓展打下了坚实基础。

Y1999

汪良恩先生 (现安芯集团董事长) 带领团队在台湾半导体 (TSC) 成功研发出Photo Glass工艺GPP芯片产品, 为当时国内第一条量产的PG-GPP芯片生产线。

Y2007

李建利先生 (现安芯集团TVS产品技术负责人) 带领技术团队在深圳君耀 (BK) 设立了TVS产品线, 为国内最早量产TVS产品的公司之一。



专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



核心团队成員



□ 林照煌 - 集团公司董事长特助

- 1) 30余年半导体芯片及元器件技术研发经验，业内资深GPP芯片技术专家；
- 2) 曾先后就职于TSC/Gulf/YJ等知名半导体企业，帮助上述企业完成GPP芯片线的创建及提升；
- 3) 目前主管集团公司研发和品质工作。

□ 张小明 - 安芯常务副总

- 1) 具有20余年半导体元器件制造经验，生产和项目管理专家，安芯电子创始人之一；
- 2) 曾就职于Gulf/TSC知名半导体企业，全程参与海湾电子GPP产品线的设立；
- 3) 拥有20项实用新型专利。

□ 王泰国 - 集团公司品质/销售副总

- 1) 2001年毕业于西安交通大学管理学院，业内资深品质管理专家，从事品质管理工作20余年；
- 2) 与电子行业国际知名企业Apple、Samsung、Philips、Delta等丰富的品质合作经验；
- 3) 汽车行业五大质量管理工具资深内训师，在半导体行业品质管理实务运作中取得良好成效。

□ 杨华 - 安美运营副总技术带头人

- 1) 工业电气自动化专业，具有20余年半导体元器件制造经验；
- 2) 曾先后就职于MIC/Gulf/YJ等知名半导体企业；
- 3) 熟知分立器件系列产品的全部封装制程，丰富的半导体元件封测技术及生产管理经验。

□ 王锡康 - 芯源微总经理技术负责人

- 1) 国内半导体膜状扩散源专家，纸源研发和制造20余年；
- 2) 成功研发膜状扩散源产品并形成国内第一条量产生产线；
- 3) 是国内唯一掌握纸源技术的专家，拥有多项发明及实用新型专利和专有技术。

专业进取

客户至上

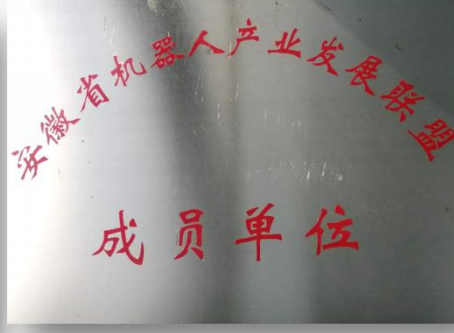
人尽其才

亲如一家



研发技术优势

- 1) 公司是国家高新技术企业和安徽省省认定企业技术中心;
- 2) 公司核心管理层在半导体材料+芯片+封测领域均具有非常丰富的产品+制程研发设计能力;
- 3) 公司在上述领域拥有28项发明专利和200项实用新型专利。



专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



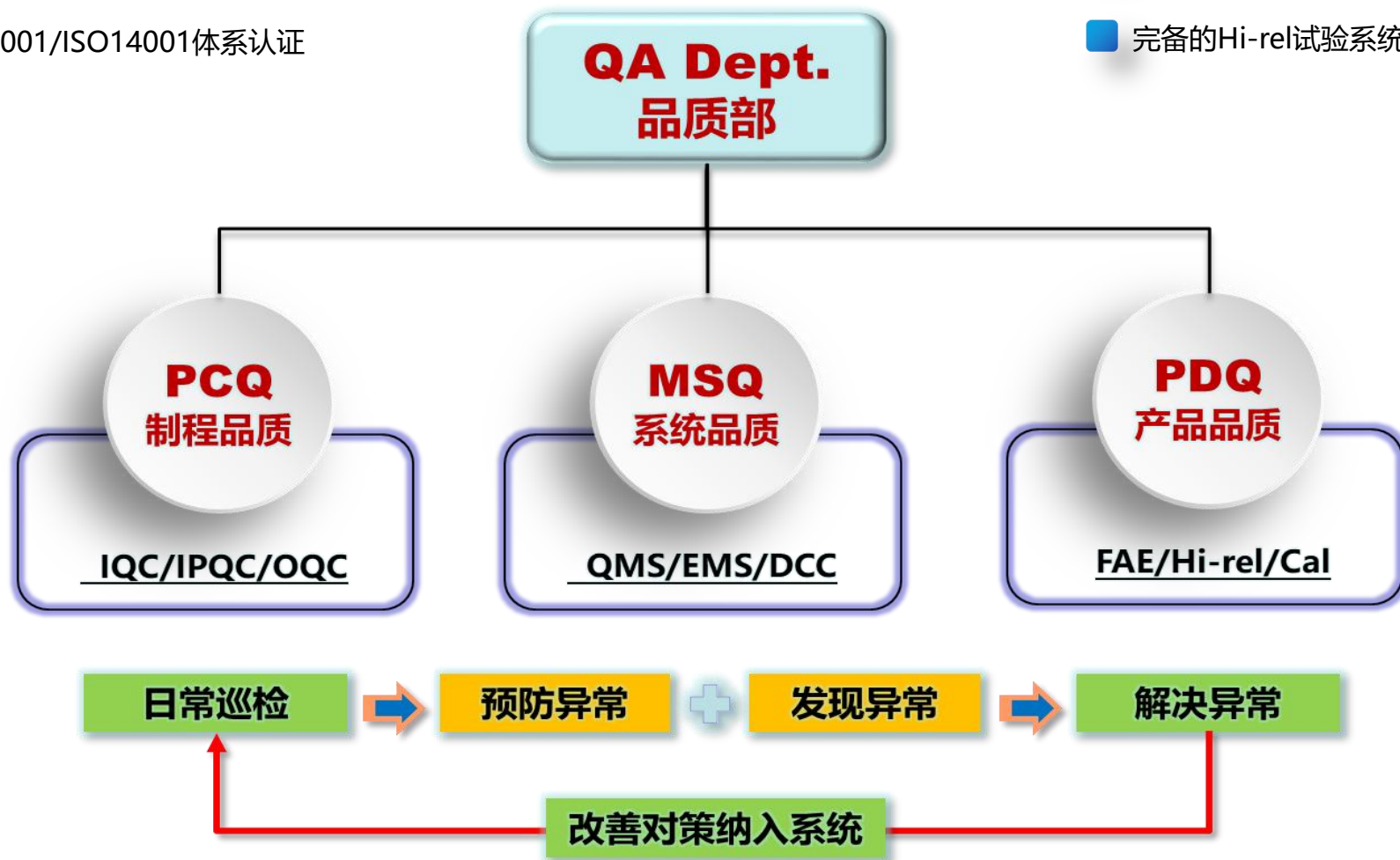
完善的品控系统

■ 独特的品质系统架构设计

■ IATF16949/ISO9001/ISO14001体系认证

■ 在线数据检测及SPC系统

■ 完备的Hi-rel试验系统及FA失效分析能力



专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家

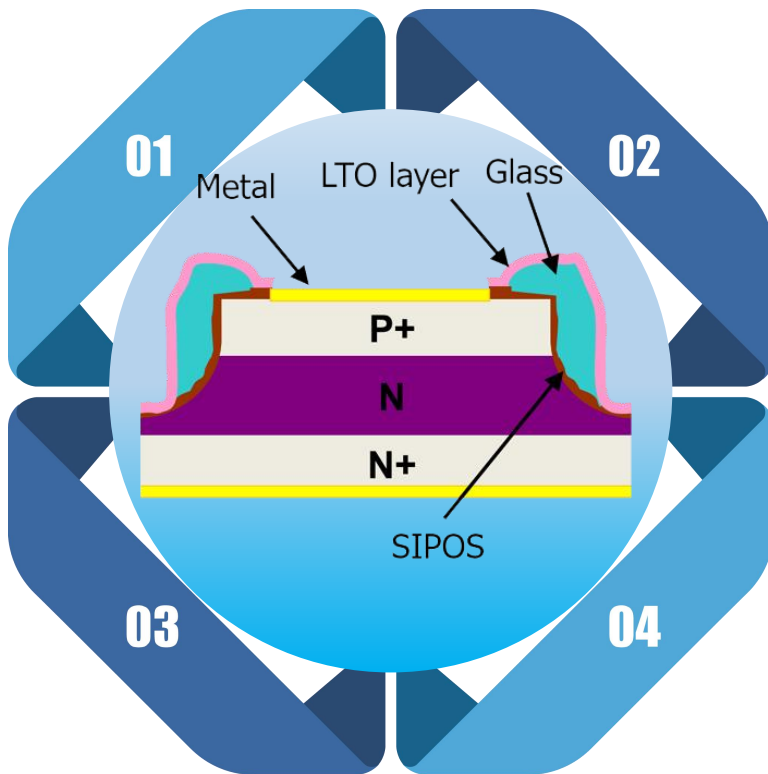


❖ 低阻抗缓变结扩散技术

- ❑ 安芯芯片选用业内先进的低阻抗、缓变结扩散技术；
- ❑ 可有效提升产品耐反向浪涌冲击的性能，极大的提高了成品的Hi-rel能力。

❖ 领先的SIPOS沉积技术

- ❑ 全自动/全程软体监控的进口LPCVD设备；
- ❑ 行业领先的SIPOS技术理论及工艺控制方法；
- ❑ 20余年的SIPOS生产技术经验。



❖ PG-GPP芯片工艺

- ❑ PG工艺的产品结构切割时不需要切割玻璃而只切割硅层，彻底改善了由于切割导致玻璃隐裂的潜在失效风险；
- ❑ PG工艺的产品增加了LTO膜的保护，可避免封装制程焊锡压玻璃，提升产品可靠性。

❖ 低漏电全系列TVS芯片

- ❑ 先进的PG工艺技术，从产品设计上提升了芯片的可靠性；
- ❑ 玻璃/SIPOS /LTO 三层钝化保护，显著提升了芯片的VC能力以及封装良率；
- ❑ 先进的TVS芯片扩散技术，10V以下产品的IR可以控制在50uA以内。



3

PART3

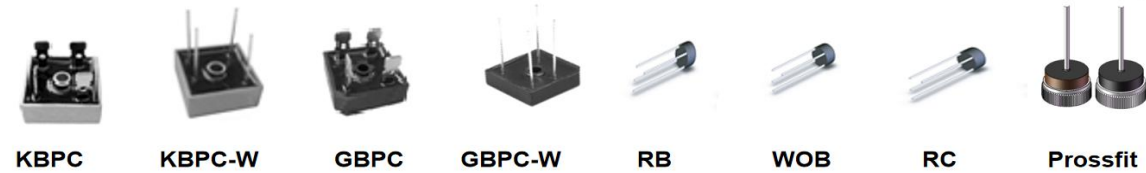
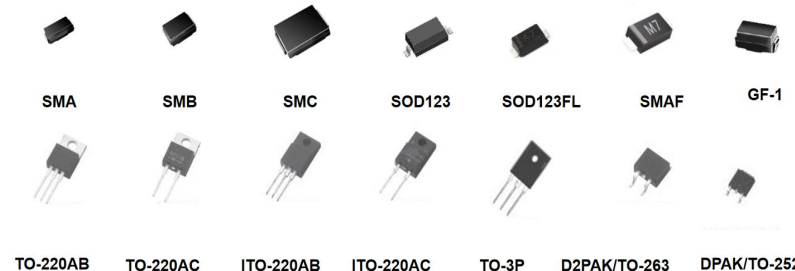
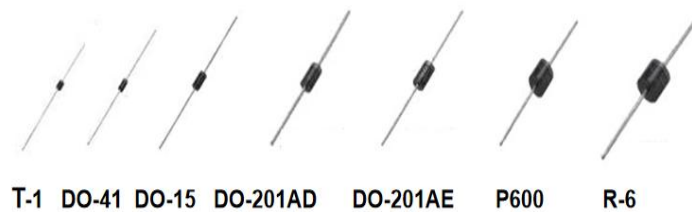
Main Products

主要产品



产品封装系列

Small Signal
Diodes
Bridge
Current Product



专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



主要核心产品-车规级STD-GPP芯片

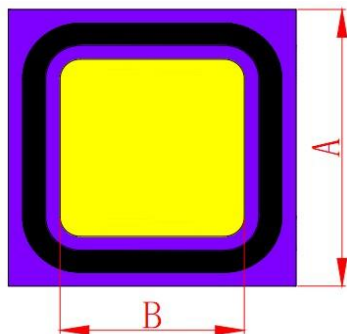
◆ 核心工艺

PG/DB+LPCVD (SIPOS+LTO)

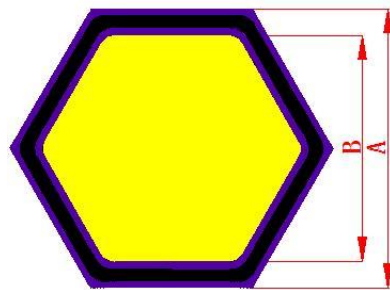
◆ 产品优势:

- 1) 行业领先的Photo Glass、D/B工艺技术，从技术上提升了芯片的可靠性。
- 2) Sipos (半绝缘多晶硅) +Glass (玻璃) +LTO (低温氧化膜) 三层钝化保护，显著提升了芯片的抗高温能力以及封装良率。
- 3) 低阻抗扩散技术、极大的提升了芯片的抗反向浪涌冲击能力，充分降低了器件的失效率,从而提高了器件的可靠性。
- 4) **产品已通过SGS三方实验室AEC-Q101测试，5年汽车客户供货经历。**

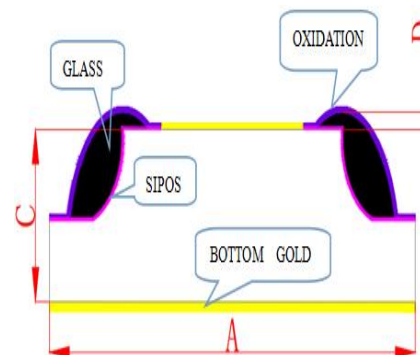
◆ 芯片结构图



正视图(方形)



正视图 (六边形)



剖面图



主要核心产品-雪崩型超高压STD芯片

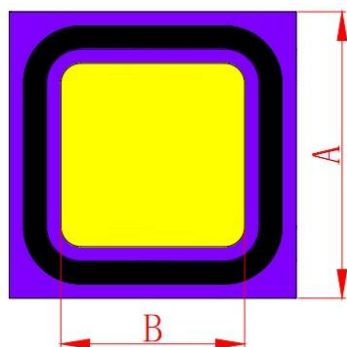
◆ 核心工艺

FZ+Photo Glass (或者 Double Moat)+LPCVD (Sipos+LTO)

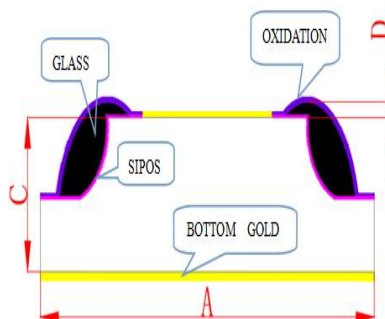
◆ 产品优势

- 1) 采用双沟、宽玻璃的玻璃钝保护技术，较大的提升了芯片的玻璃钝化保护性能。
- 2) 采用Sipos (半绝缘多晶硅) +Glass (玻璃) +LTO (低温氧化膜) 三层钝化保护，极大的提升了芯片的抗高压、抗高温性能。
- 3) 低应力、缓变结的扩散技术，极大的提升了芯片的雪崩特性、高耐反向浪涌冲击能力、高可靠性能力。

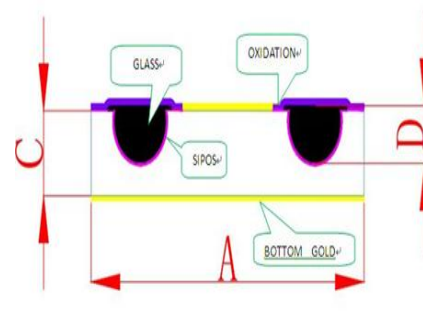
◆ 芯片结构图



正视图



剖面图 (Single Moat)



剖面图(Double Moat)



主要核心产品-高可靠性FRD-GPP芯片

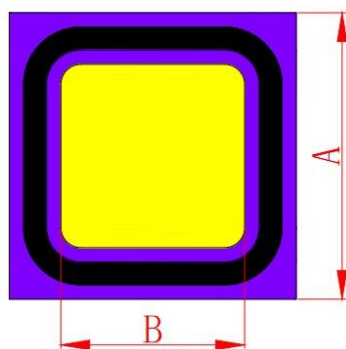
◆ 核心工艺

Photo Glass + LPCVD (Sipos+LTO)

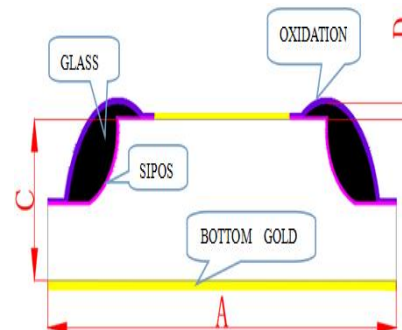
◆ 产品优势

- 1) 行业领先的Photo Glass工艺技术，从技术上提升了芯片的可靠性。
- 2) Sipos (半绝缘多晶硅) +Glass (玻璃) +LTO (低温氧化膜) 三层钝化保护，显著提升了芯片的抗高温能力以及封装良率。
- 3) 快速且一致性好的TRR分布。
- 4) 有竞争性的成本及价格。

◆ 芯片结构图



正视图



剖面图



主要核心产品-高可靠性FRED-GPP芯片

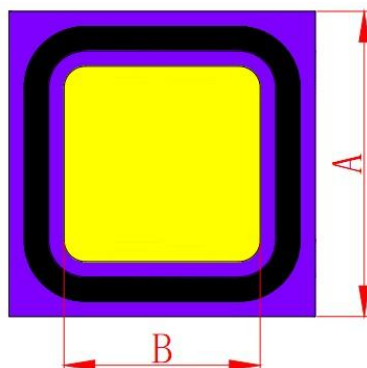
◆ 核心工艺

Photo Glass + LPCVD (Sipos+LTO)

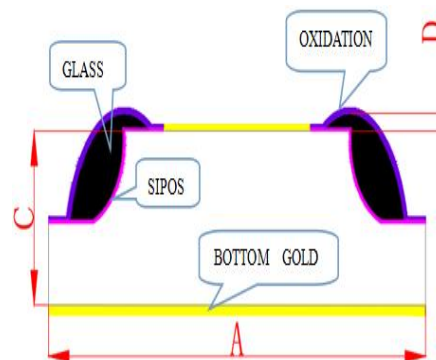
◆ 产品优势

- 1) 采用行业领先的Photo Glass工艺技术，从基础上提升了芯片的可靠性。
- 2) 采用多层外延技术，显著提升了产品的软恢复特性，增强了产品的抗线路的冲击的能力，提升了产品的可靠性。
- 3) 均匀的TRR分布以及超低的VF分布，体现了芯片优良的常温特性。

◆ 芯片结构图



正视图



剖面图



主要核心产品-车规级TVS/Zener-GPP芯片

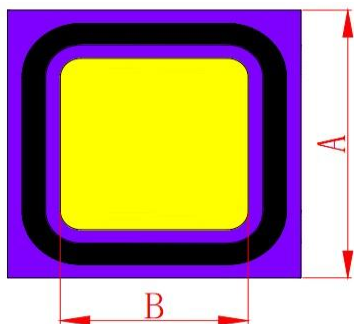
◆ 核心工艺

PG/DB + LPCVD (Sipos+LTO)

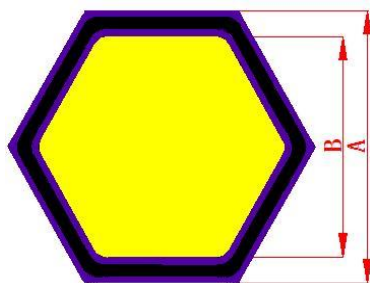
◆ 产品优势

- 1) 行业领先的Photo Glass工艺技术，从技术上提升了芯片的可靠性。
- 2) Sipos (半绝缘多晶硅) +Glass (玻璃) +LTO (低温氧化膜) 三层钝化保护，显著提升了芯片的VC能力以及封装良率。
- 3) 行业领先的TVS芯片扩散技术，10V以下600W产品IR可以控制在50UA以内。
- 4) **产品已通过SGS三方实验室AEC-Q101测试，5年以上汽车客户供货经历。**

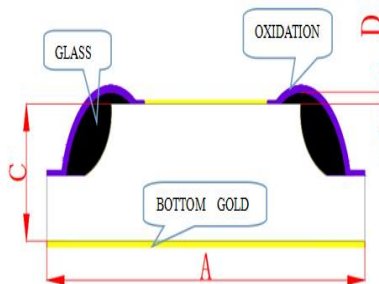
◆ 芯片结构图



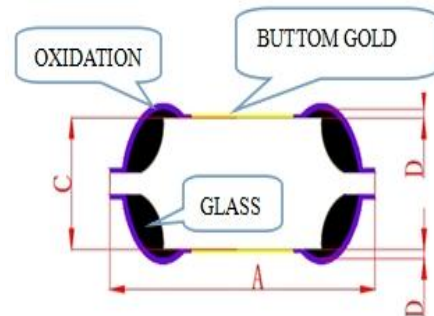
正视图(方形)



正视图 (六边形)



截面图 (单向)



截面图 (双向)



主要核心产品-车规系列

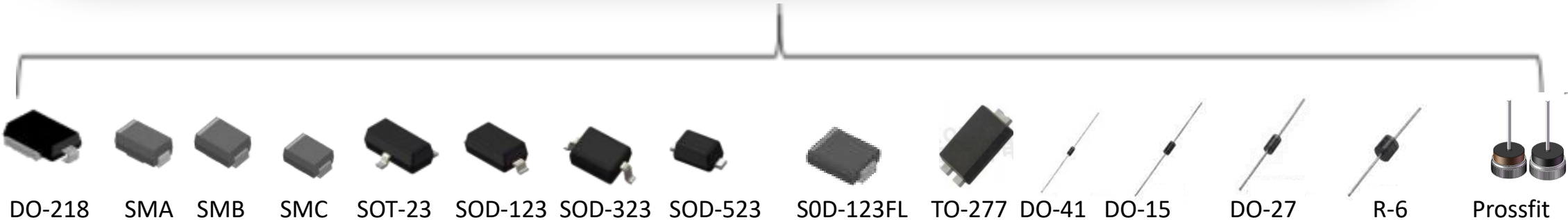
产品大类

- 整流/快恢复二极管 I_F : 1A ~100A V_{BR} : 50V~2000V
- 肖特基二极管 I_F : 1A ~60A V_{BR} : 20V~250V
- TVS/Zener二极管 Power: 200W ~30KW V_{WM} : 5.0V~500V
- 小信号开关二极管 I_F : 0.125A ~0.25A V_{BR} : 75V ~250V
- 小信号稳压二极管 Power: 200mW~500mW Voltage: 2.4V~47V
- 小信号肖特基二极管 I_F : 0.03A ~1A V_{BR} : 20V~100V
- 小信号三极管 I_C : 0.1A ~1.5A V_{CBO} : 30V~300V

产品优势

- 5年以上汽车一级供应商客户合作经验。
- 汽车电子制程方法确保工艺参数控制免出错。
- 先进的自动化生产设备确保产品精度和稳定的可靠性。
- 先进的MES制造系统监控产品生产流程。
- 所有产品开发均按照APQP流程进行管理。

产品封装外形



专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



主要核心产品-MOSFET



专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



主要核心产品-模块/IGBT

产品大类

- 整流模块
 I_F : 30A~250A V_{BR} : 800V~2400V
- 晶闸管模块
 I_T : 25A~200A V_{BR} : 800V~2200V
- 快恢复模块
 I_F : 100A~500A V_{BR} : 400V~1200V
- 肖特基模块
 I_F : 100A~800A V_{BR} : 100V~200V
- IGBT单管
 I_F : 10A~75A V_{BR} : 650V~1200V
- IGBT模块
 I_C : 10A~600A V_{CES} : 600V/1200V/1700V

产品优势

行业标准封装 Trench FS芯片技术 全自动化生产管控 100%动静态测试筛选

优良的高温特性 ($T_{jmax}=175^{\circ}C$) ;
低 $V_{ce(sat)}$ + 低开关损耗;
优良一致性, 适合并联使用;

产品应用

整流模块
工业变频器
电焊机
不间断电源
直流电机电源

晶闸管模块
电机控制与驱动
电池充电
加热器控制
静态开关电源
不间断电源

快恢复和肖特基模块
电焊机
电镀电源
功率因数调整
直流电机供电线路

IGBT单管&模块
工业变频器
感应加热
电焊机
伺服电机
光伏逆变器
充电桩



主要核心产品-SiC系列

产品大类

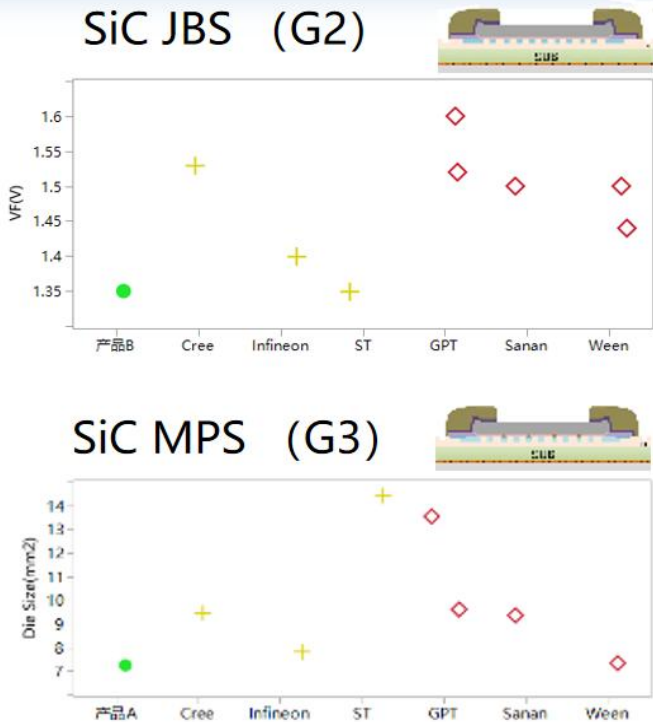
- SiC SBD Diode 1200V 2-40A
- SiC SBD Diode 650V 2-40A
- SiC MOSFET 1200V 40-80mΩ

产品优势

- 达到行业标杆同等级别性能;
- 通过了严苛的可靠性考核;
- 具备客制化设计能力;

1200V/20A 器件性能横向比较

1200V/20A	G2	G3	竞品水平
设计理念	低VF	低成本	
结构	JBS	MPS	MPS/JBS
VF (预期)	1.35 V	1.5 V	1.42-1.60 V
浪涌 (预期)	> 170 A	> 170 A	125-270 A
芯片厚度	180 um	180 um	120-350 um
Die Size (估值)	3.1*3.1 mm ²	2.7*2.7 mm ²	2.7 ² -3.7 ² mm ²
BV (预期)	1500 V	1500 V	1350-1700 V
IR@1200V (预期)	<1 uA	<1 uA	0.1-20 uA
雪崩能力 (预期)	1000 mJ	1000 mJ	500-1000 mJ



产品主要应用领域



汽车电子



光伏太阳能



家电



电源



电动工具



工程安防



服务器/5G基站



LED 照明



仪表仪器



电池/储能



医疗电子



手机



安防电子



智能穿戴



无人机

专业进取

客户至上

人尽其才

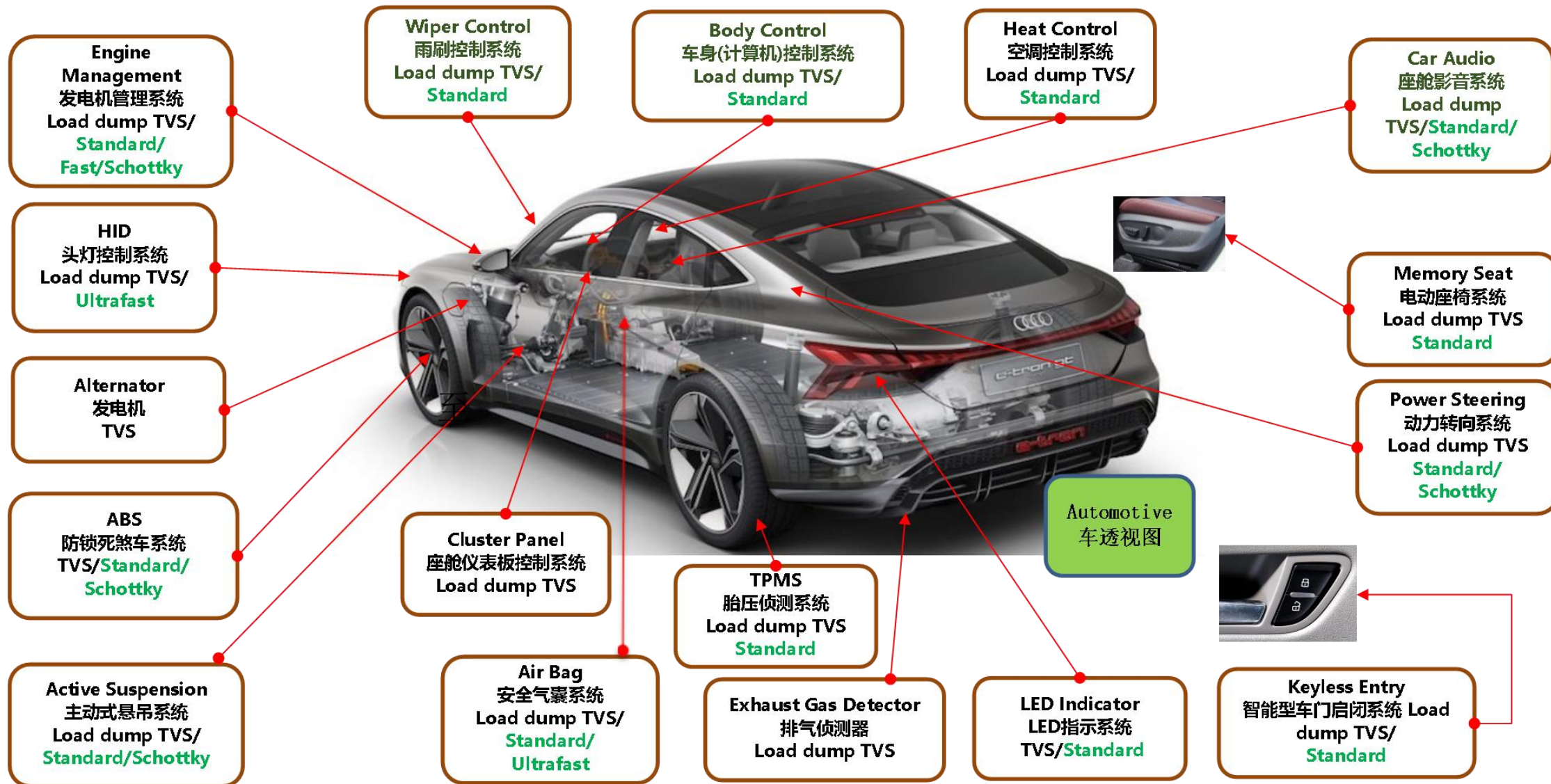
亲如一家



整车ECU电控单元应用场景

Anxin

安徽安芯电子科技有限公司
Anhui Anxin Electronic Technology Co., Ltd.



专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



汽车发动机点火器应用场景

燃油发动机



高压适配器

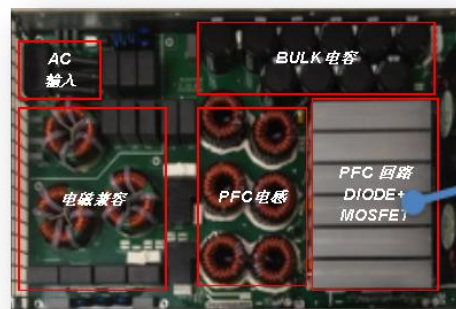
□ HVS40N/BYX134系列高压整流二极管



新能源充电桩应用场景

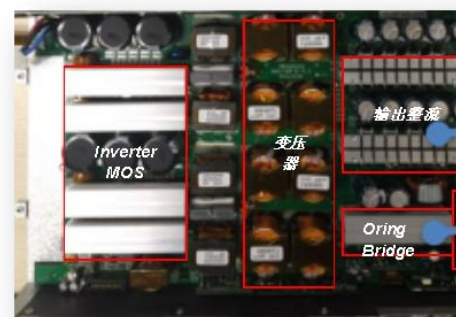


充电桩模块



PFC回路

- MURXX/SFXX系列快恢复FRED产品
- 400W系列TVS产品
- 600W系列TVS产品
- 800W系列TVS产
- 1500W系列TVS产品
- 3000W系列TVS产品



输入及输出整流

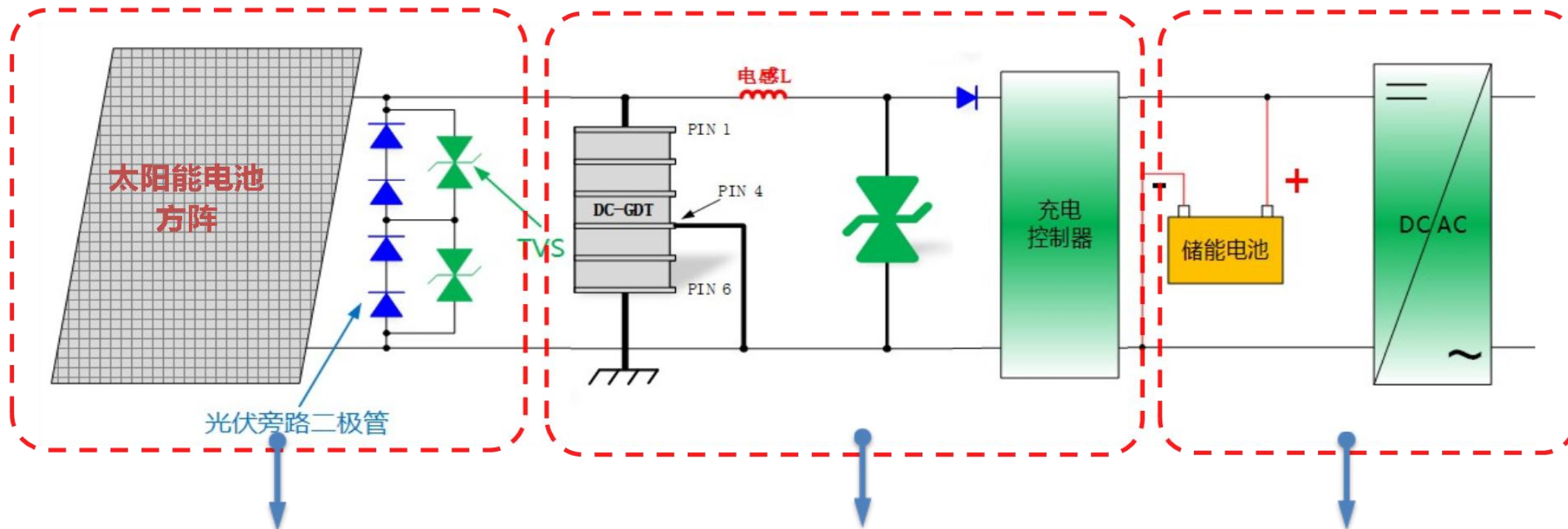
- MURXX/SFXX系列快恢复FRED产品
- GBJ25A/35A系列整流桥堆产品
- 400W系列TVS产品
- 600W系列TVS产品
- 800W系列TVS产
- 1500W系列TVS产品
- 3000W系列TVS产品

专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



光伏发电

- SMAJ-400W系列TVS产品
- SMBJ-600W系列TVS产品
- SMBJ-800W系列TVS产
- SMCJ-1.5KW系列TVS产品
- SMDJ-3KW系列TVS产品
- SMDJ-5KW系列TVS产品
- SKY系列旁路二极管产品

充电控制

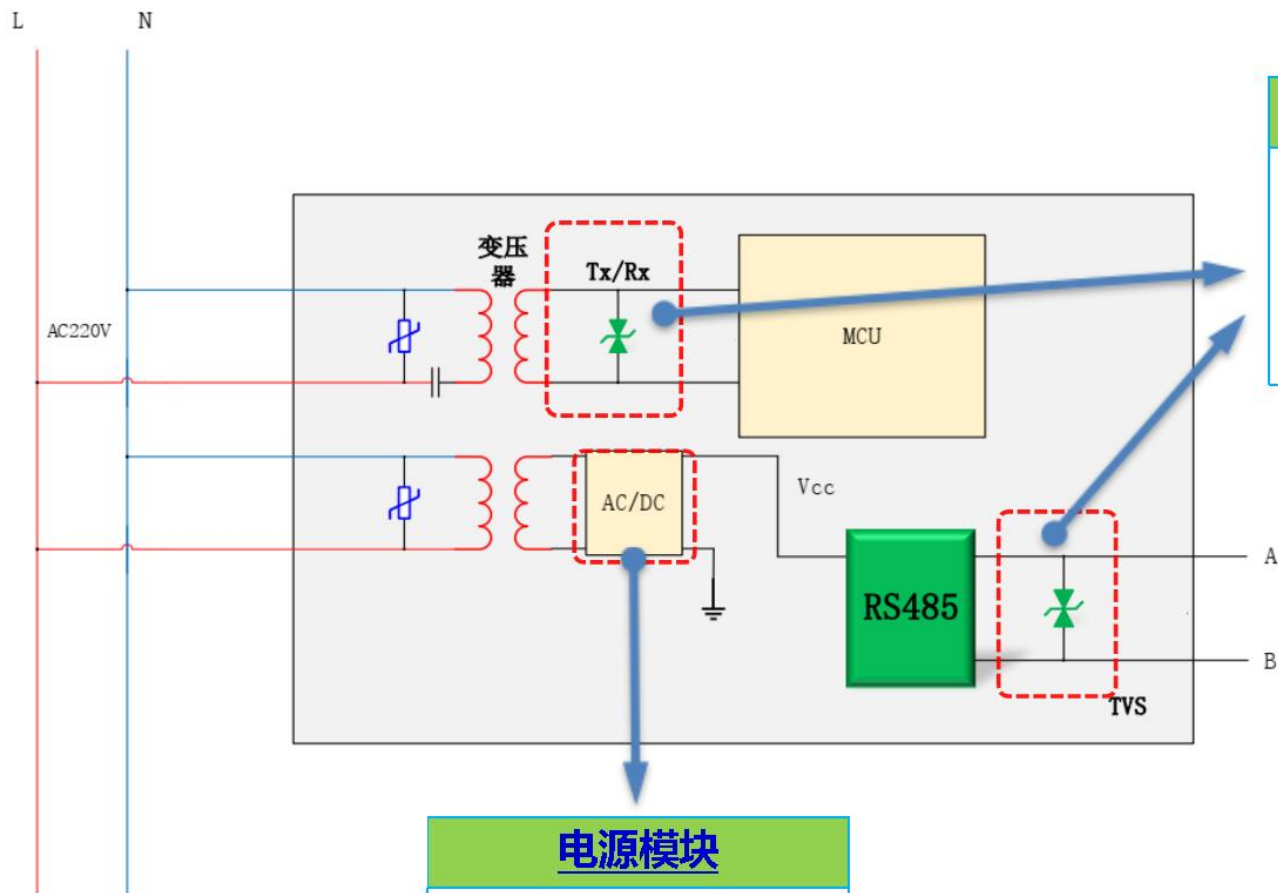
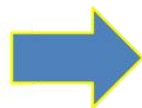
- SMAJ-400W系列TVS产品
- SMBJ-600W系列TVS产品
- SMBJ-800W系列TVS产
- SMCJ-1.5KW系列TVS产品
- SMDJ-3KW系列TVS产品
- 218-5/8KW系列TVS产品
- FRED系列快恢复产品

储能及逆变

- SMAJ-400W系列TVS产品
- SMBJ-600W系列TVS产品
- SMBJ-800W系列TVS产
- SMCJ-1.5KW系列TVS产品
- SMDJ-3KW系列TVS产品
- 218-5/8KW系列TVS产品
- FRED系列快恢复产品



智能电表应用场景



线路保护

- SMAJ-400W系列TVS产品
- SMBJ-600W系列TVS产品
- SMBJ-800W系列TVS产
- SMCJ-1.5KW系列TVS产品

电源模块

- MURXX/SFXX系列快恢复FRED/FRD产品
- STD系列整流桥/整流二极管产品

专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



通讯基站应用场景

供电电源

- MURXX/SFXX系列快恢复FRED/FRD产品
- STD系列整流桥/整流二极管产品

主设备机柜

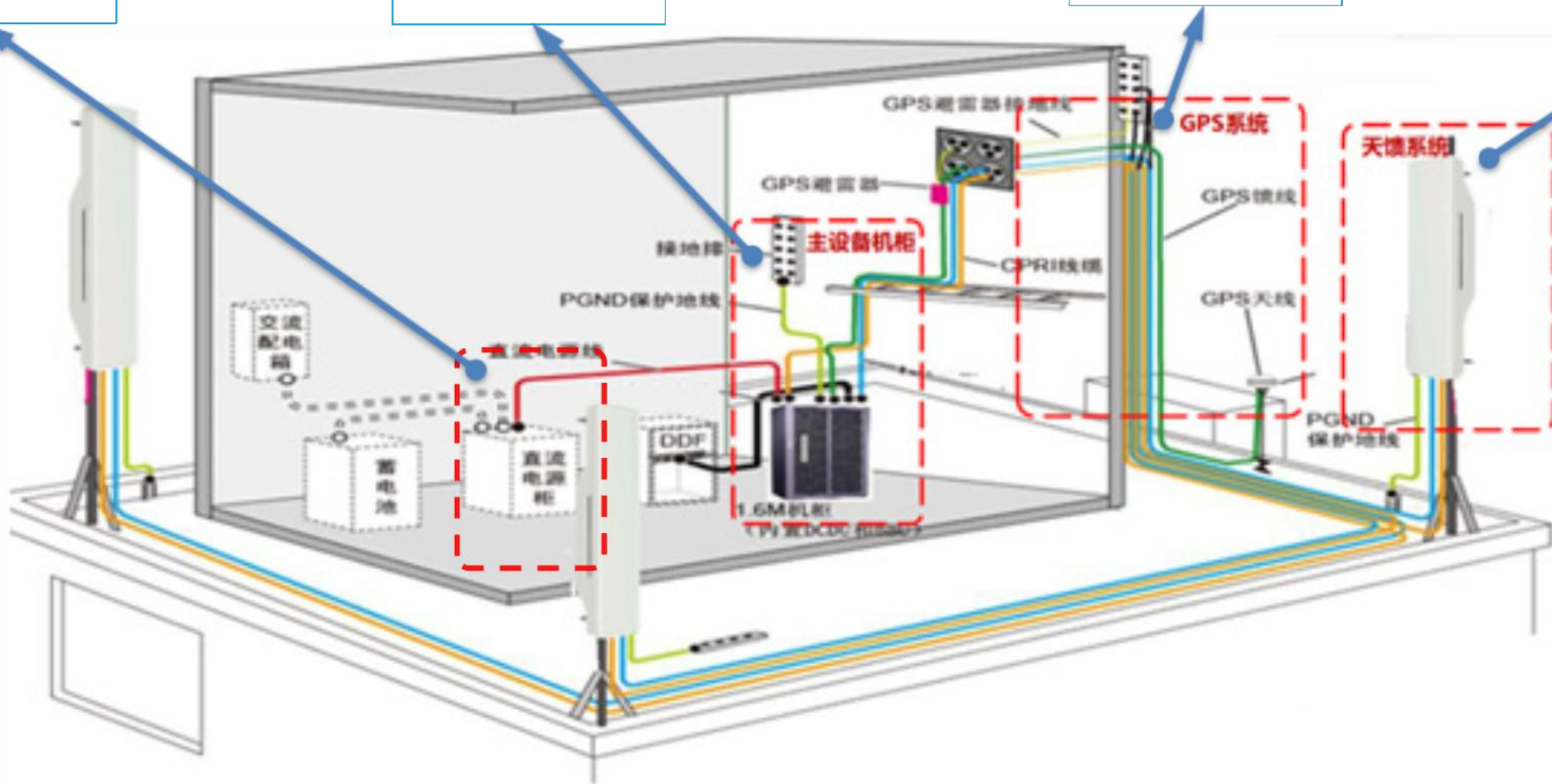
- 400W-5kW系列TVS钳位保护系列产品
- ESD系列静电吸收保护系列产品

GPS系统

- 400W-5kW系列TVS钳位保护系列产品
- ESD系列静电吸收保护系列产品

天馈系统

- 400W-5kW系列TVS钳位保护系列产品
- ESD系列静电吸收保护系列产品



专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



安防系统应用场景



专业进取

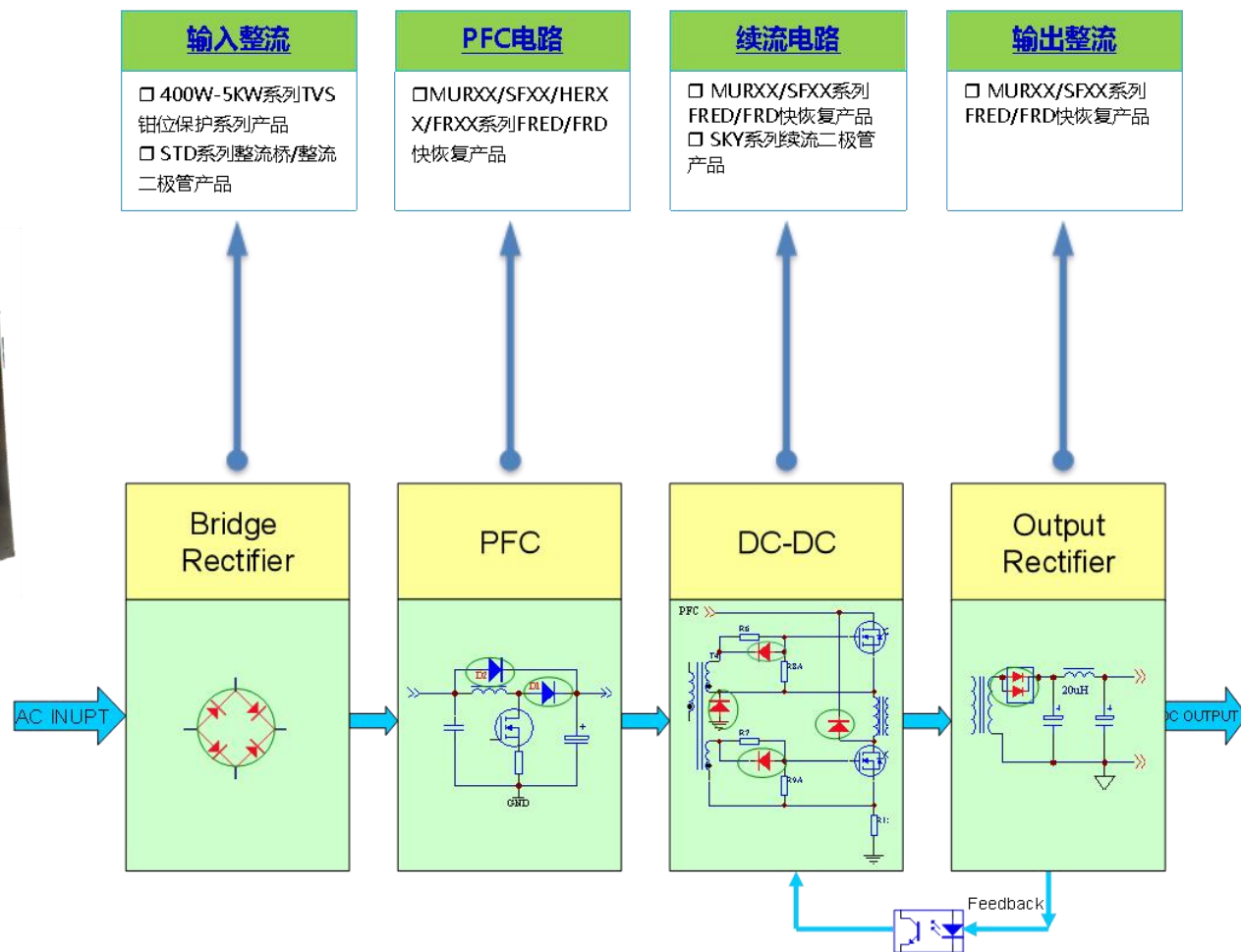
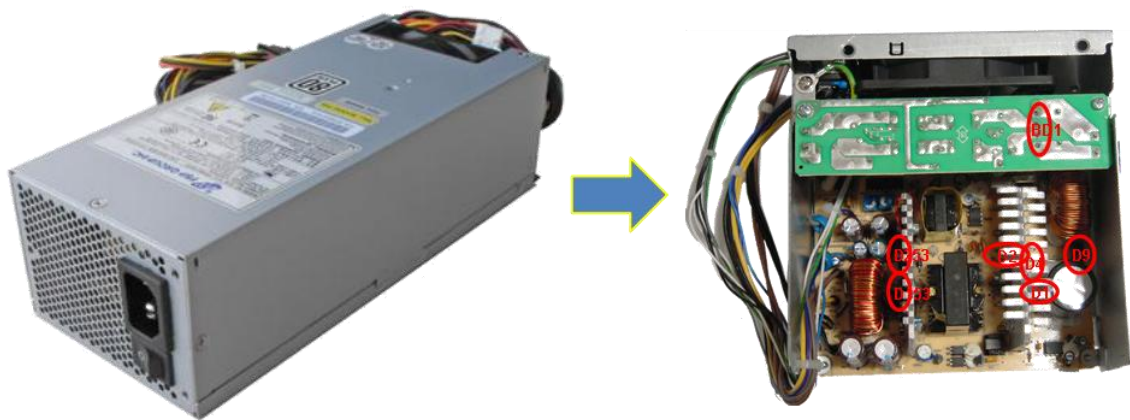
客户至上

人尽其才

亲如一家



工控电源应用场景



专业进取

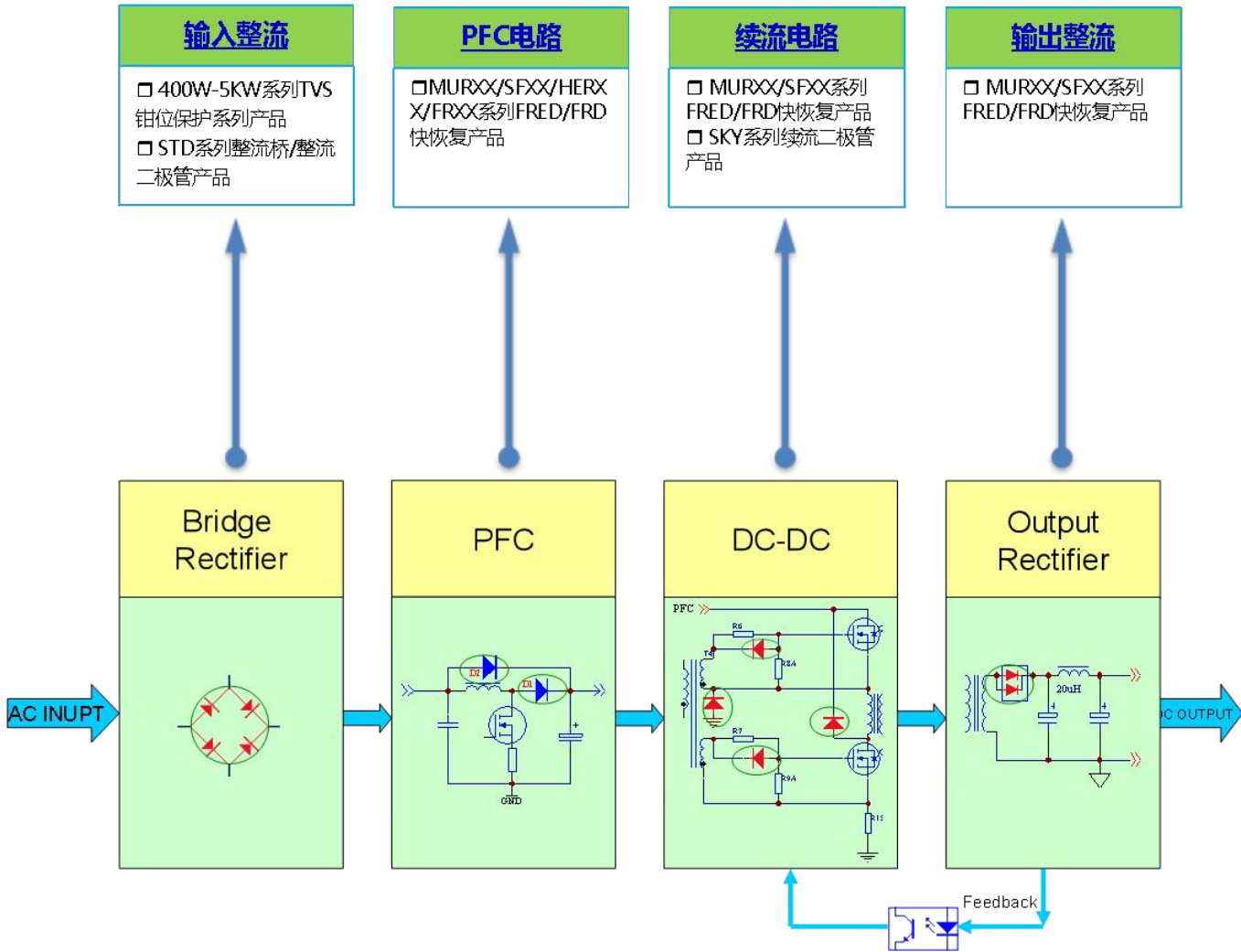
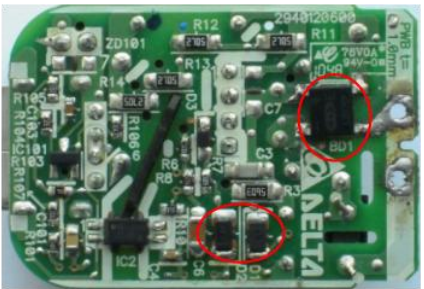
客户至上

人尽其才

亲如一家



PD快充应用场景



专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



4

PART4

Quality & RD

品质控制系统



QMS/AEC-Q/EMS/HSPM资质认证



安徽安芯电子科技股份有限公司
Anhui Anxin Electronic Technology Co., Ltd.

IATF 证书号 0495779
此为证书 CN21/10214.01 译本
下述组织

安徽安芯电子科技股份有限公司

IATF ISO: 9001
中国安徽省滁州市经济技术开发区富安电子信息产业园10号厂房3楼
安徽安芯电子科技股份有限公司
IATF ISO: 16949
中国安徽省滁州市经济技术开发区凤阳大道98号1号厂房3楼

管理体系已经过审核，并被证明符合下述要求

IATF 16949:2016

版本 1

所涉及的活动范围涵盖
半导体分立器件二极管及其芯片的设计和制造

不附加：无

3 年 从证书有效日期 2024 年 04 月 13 日 至 2027 年 04 月 12 日 并须经符合要求的监督审核保持有效
版本号 2 当前版本更新于 2024 年 04 月 13 日

签署
Issued by:
Noto Power Authority
Contracted Office: SGS United Kingdom Ltd, Station Road, Oldbury, BPP 4X, UK.
Email: Not1.Hall@sgs.com



本证书是真实的电子证书，仅供客户用于内部用途，客户可自行打印，视同正本。本文件根据《Noto and C
中认证体系标准条款的要求，由认证机构中已包含的责任范围、范围和管理事项。本文件受SGS版权保
保护的对此文件的内容或外部的发布、制造或修改均无效。

第 1 页共 2 页

符合性认证证书

证书编号: CN SEM1 SUZ202403004_CN 发证日期: 2024

订单编号: RSU-CERT40300011-01

申请方: 安徽安芯电子科技股份有限公司

申请方地址: 安徽省滁州市经济技术开发区富安电子信息产业园10号

我们已对送检的样品开展了相关测试，其符合

产品名称: 2.05MBJ30CA Diode

产品型号: 2.05MBJ30CA

测试标准: AEC-Q 101-REV-E-2021

测试报告编号: SUZRL2023120054

通标标准技术服务有限公司半导体及可靠性测试实验室按照上标准对上述提及的产品样品
于该测试结束向申请方出具此符合性认证证书。

授权签字人



Jeffery Xiao

实验室经理

半导体及可靠性测试实验室



本证书由通标标准技术服务有限公司分公司颁发，未经
本公司书面批准，本文件不得进行复制、本证书根据《国际通用
标准》出版，即可通过<https://www.sgs.com/en/term-and-conditions>

进行查询。上述测试报告所涉及的法律责任由本证书持有者承担。
任何未经授权的对本证书内容或外部的发布、制造或修改均无效。
行为，该行为将导致认证资格被撤销。

通标标准技术服务有限公司苏州分公司

地址: 苏州市工业园区星港路 69 号一

Tel: 86-512-6298 8235; sgs.china@sgs.com

此为证书 CN20/10283.00 译本

下述组织

安徽安芯电子科技股份有限公司

统一社会信用代码: 91341200655728200C
注册地址: 安徽省滁州市经济技术开发区富安电子信息产业园10号
经营地址: 中国安徽省滁州市经济技术开发区富安电子信息产业园10号
的管理体系已经过审核，并被证明符合下述要求
ISO 14001:2015

所涉及的活动范围涵盖
半导体分立器件二极管及其芯片的设计和制造

该证书的有效期自 2023 年 07 月 30 日 至 2026 年 07 月 29 日 并须经符合要求的监督审核保持有效
版本号 2 初始注册日期 2014 年 07 月 30 日
在此范围内出具了多张证书，主证书编号为 CN20/10283.00
在其他场所实施的认证活动在后续页面上列出

签署
Jonathan Hall
Global Head - Certification
Services

SGS United Kingdom Ltd
Rosemead Business Park, Ellensmead, Cheshire, CH65 3BN, UK
t +44 (0)151 350 9000 - www.sgs.com



本证书是真实的电子证书，仅供客户用于内部用途，客户可自行打印，视同正本。本文件根据《Noto and C
中认证体系标准条款的要求，由认证机构中已包含的责任范围、范围和管理事项。本文件受SGS版权保护。
对此文件的内容或外部的发布、制造或修改均无效。

第 1 页共 2 页



IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM (IECQ)
covering Electronic Components,
Assemblies, Related Materials and Processes
For rules and details of the IECQ visit www.iecq.org

IECQ Certificate of Conformity Hazardous Substance Process Management

IECQ Certificate No.:	IECQ-H 80804 23.0047	Issue No.:	1	Status:	Current
Supersedes:		Issue Date:	2023/07/18	Org Issue:	2023/07/18
CS Reference No.:	CN 23/00 003758	Expiry Date:	2026/07/17		

Applicable to:

- European Directive 2011/65/EU ("RoHS - Restriction of the use of certain Hazardous Substances") in electrical and electronic equipment, including all published amendments
- Customer specified requirements

Anhui Anxin Electronic Technology Co., Ltd.

Floor 3, No. 10, Fuan Electronic Information Industrial Park, Economic and Technological Development Zone,
Chizhou City, Anhui Province, P.R.
China

The organisation has developed and implemented Hazardous Substance Process Management procedures and
related processes which have been assessed and found to comply with the applicable requirements for IECQ
HSPM organization approval which is in accordance with the Basic Rules IECQ 01 and Rules of Procedure
IECQ 03-5 "IECQ Hazardous Substances Process Management" of the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ), and with respect to the IECQ Specification:

- IECQ QC 080008:2017 - Hazardous Substance Process Management System Requirements

This Certificate is applicable to all electronic components, assemblies, related materials and
processes for the following scope of activities:
Design and Manufacturing of Semiconductor discrete device diode chip

Issued by the Certification Body: SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.

16F Century Yuhui Mansion,
73 Fucheng Road, Beijing
China

Authorized person:
Tung Ben

签署



The validity of this certificate is maintained through ongoing surveillance audits by the
IECQ Certification Body.
The Certificate of Conformity may be suspended or withdrawn in accordance with the
Rules of the order of the IECQ System and Rules of Procedure.
This certificate and any related information may only be reproduced in full.
This certificate is not transferable and remains the property of the issuing IECQ CB.
The status and authenticity of this certificate may be verified by visiting www.iecq.org

© IECQ 2018

IECQ Form 08

专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



AEC-Q101颁证仪式



专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



AEC-Q101颁证仪式



专业进取

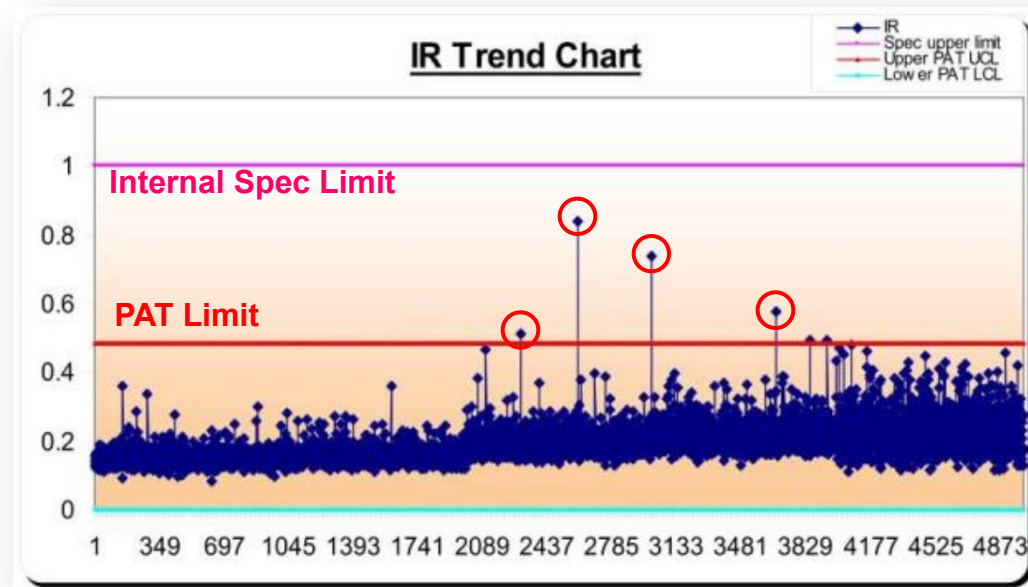
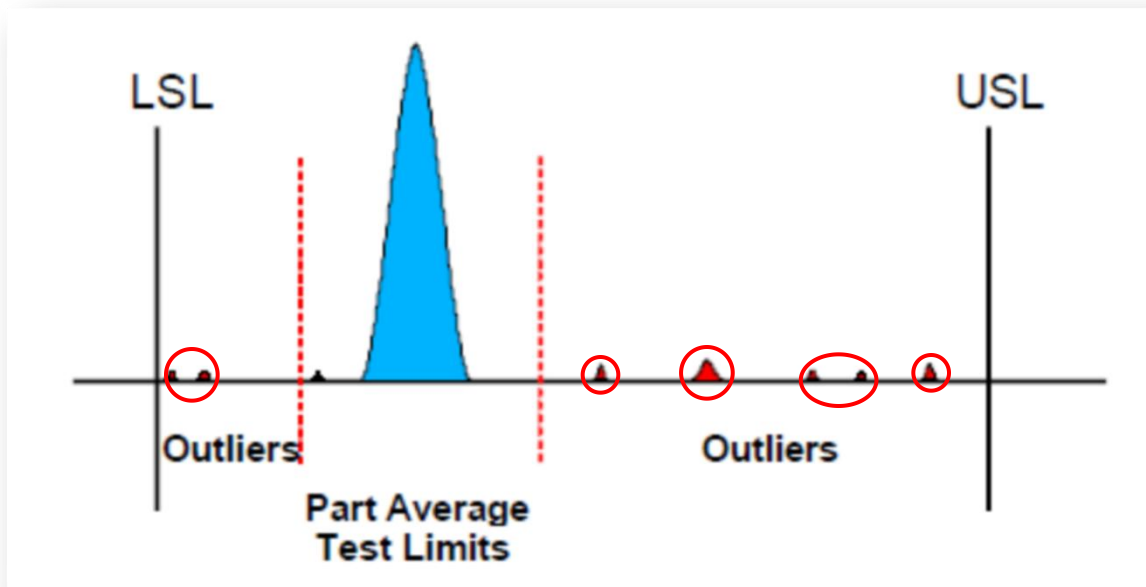
客户至上

人尽其才

亲如一家



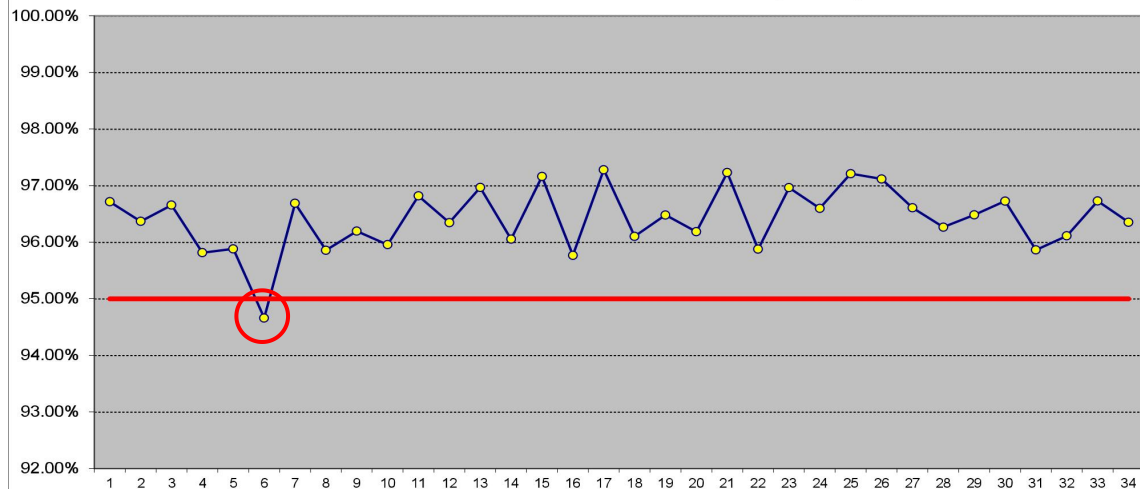
Parts Average Test 项目



我们执行 **PAT (部件平均测试)** 程序以进一步剔除在产品规格以内但电性数据分布离散的产品.历史数据显示此类产品有引发产品质量和可靠性问题的风险. PAT技术的使用也能够及时有效的反映出制程的变异，以便及时有效的采取预防改善对策，避免质量事故的发生。



STATISTICAL YIELD ANALYSIS (SYL)



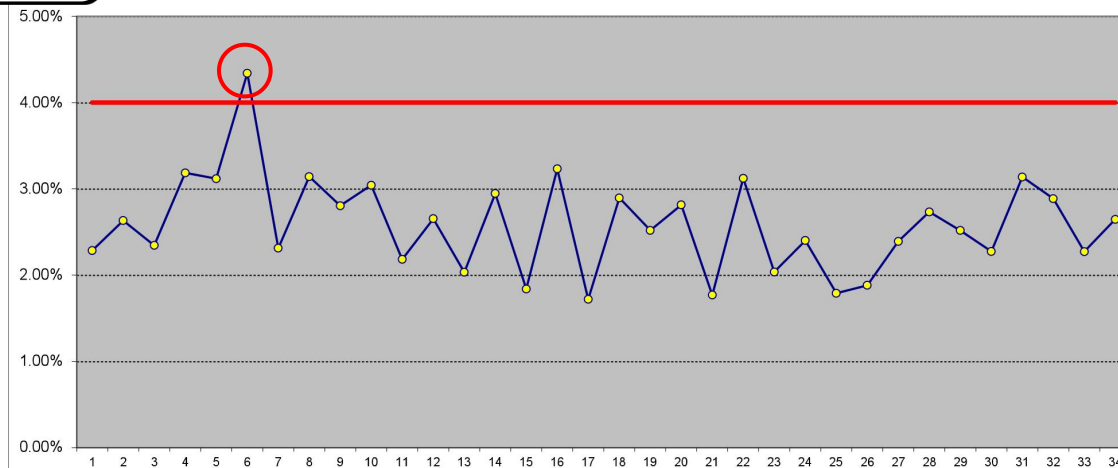
SYL (总统计良率管控)

-是经过多批次产品良率表现计算的产品总良率管控限，用于辨识和捕捉制程中产品良率异常批次以发现潜在的产品质量问题。

STBL (单项统计不良管控)

-是经计算的单项测试项目控制限，通常应用于可能导致潜在可靠性或质量隐患的关键测试参数，用于辨识和捕捉异常产品批次。

Statistic Test Bin Analysis (STBL)





The Source



*Very minor

Next Process



*Scrap
* Minor Delay

End of Line



*Repair
*Containment
*Rework
*Reschedule of work

Final Inspection



*Significant Rework
*Additional Operations
*Overtime
*Delay in delivery
*Added inspection

End Customer



*3rd Party Containment
*Premium Freight
*Administrative costs
*Warranty Costs
*Reputation
*Lost market share
*Lost business

早期
预防
&
探测

Layered Process Audits (LPA)是一种有效的风险预防和探测管理工具，LPA稽核小组由公司不同职能部门的人员组成（品质、技术、设备、生产等），从不同角度发现制程潜在风险并予以改善，目前LPA稽核项目包括：

- a) 客诉改善项目；
- b) 内部异常改善项目；
- c) 客户稽核CA项目；
- d) 产品线品质风险确认。



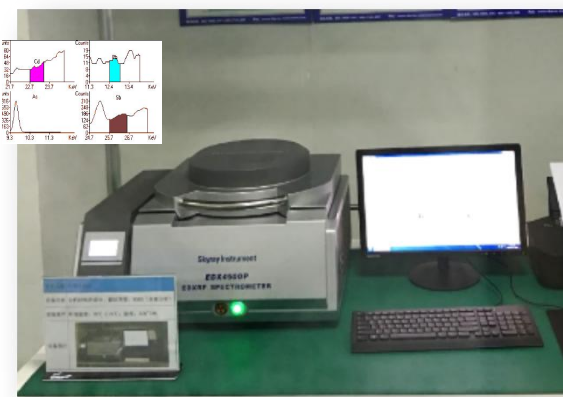
FA失效解析能力



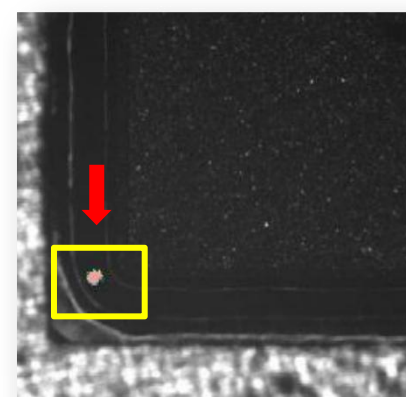
X-ray



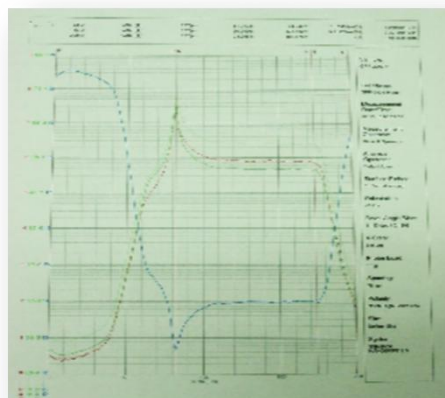
Grinding



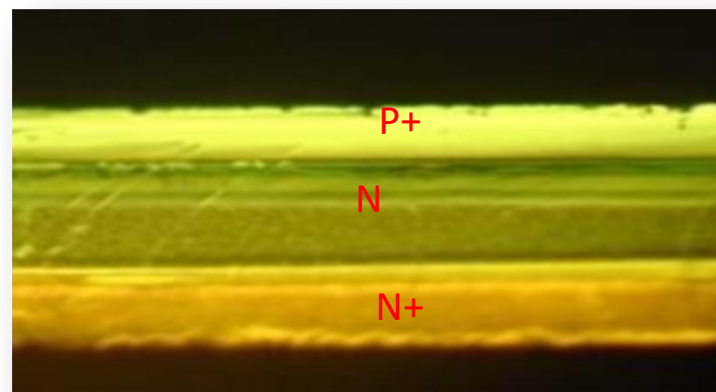
EDX tester



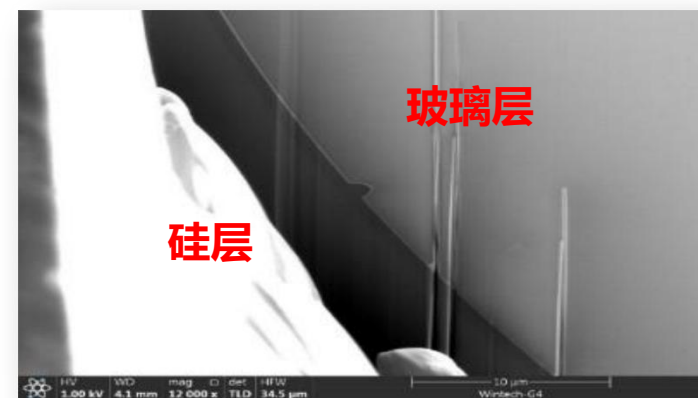
EMMI



SRP



Dice Cross-section



SEM/FIB分析

专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



公司有资质完成车规品 AEC-Q101全套实验项目测试

- 高温反偏实验系统
- 高温高湿反偏实验系统
- 功率老化实验系统
- 温度循环实验系统
- 高压蒸煮实验系统
- 耐焊接热/可焊性实验系统
- ESD测试系统
- 浪涌测试仪
- VC测试仪
- ◆ 化学解析设备
- ◆ X-ray分析设备
- ◆ EDX光谱分析设备



Hi-rel高可靠性实验设备

Anxin

安徽安芯电子科技有限公司
Anhui Anxin Electronic Technology Co., Ltd.

高温反偏实验系统



高温高湿反偏实验系统



功率老化实验系统



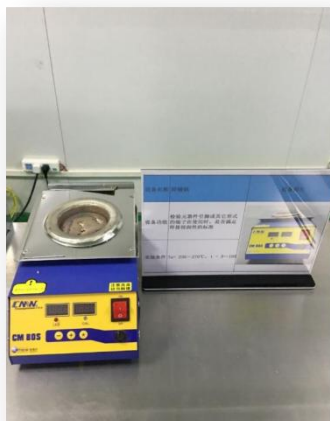
温度循环实验系统



高压蒸煮实验系统



可焊性实验设备



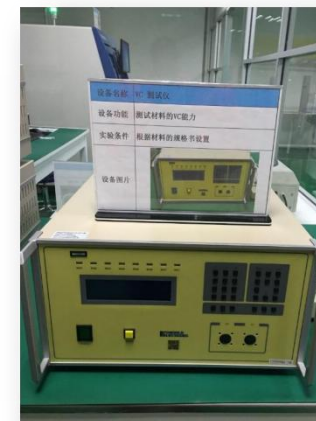
ESD试验系统



浪涌测试仪



VC测试仪



专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家

5

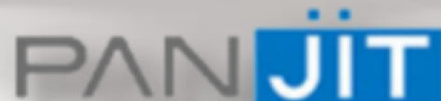
PART5

Key Accounts

重点合作客户



芯片/器件重点OEM客户



专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



整车领域重点合作客户



专业进取

客户至上

人尽其才

亲如一家



其他应用领域重点合作客户



专业进取

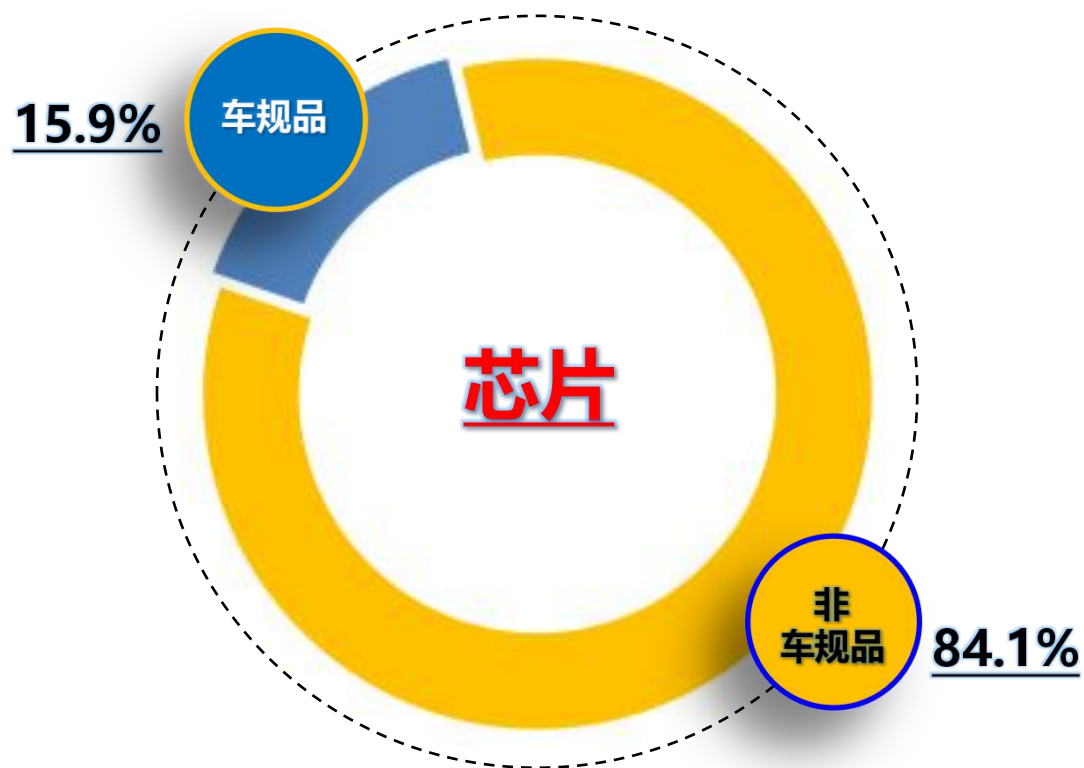
客户至上

人尽其才

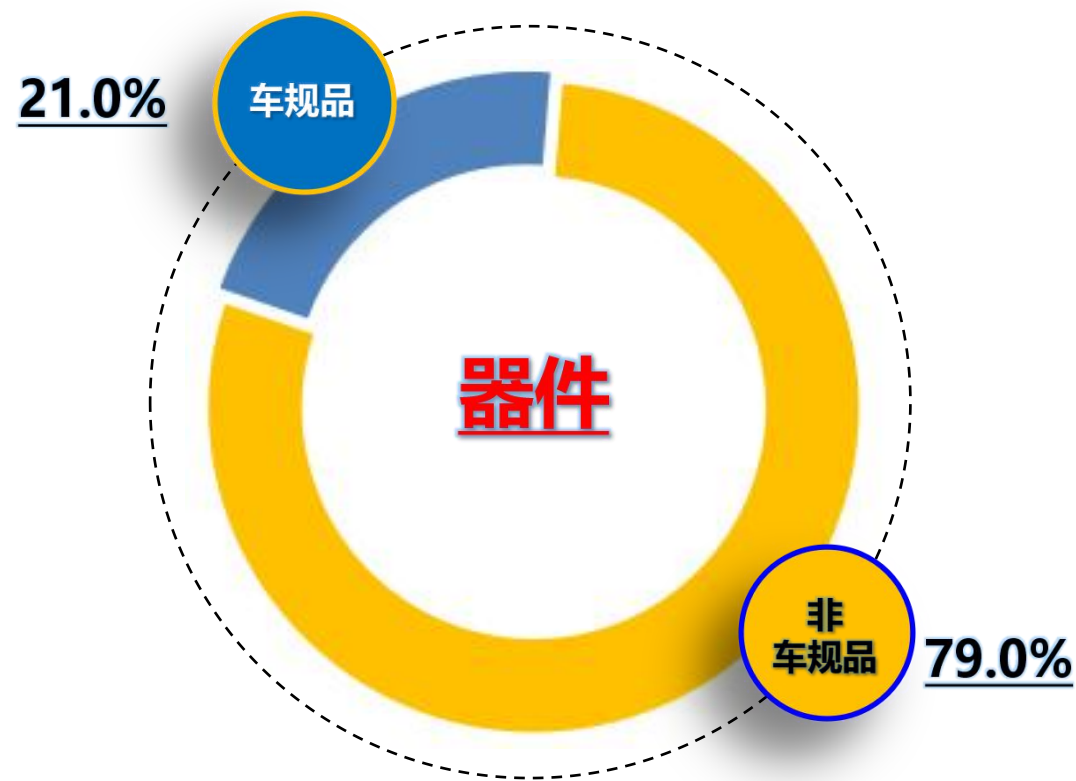
亲如一家



车规品销售占比



车规品 VS 非车规芯片销售占比为 15.9%：84.1%；



车规品 VS 非车规器件销售占比为 21.0%：79.0%；



6

PART6

Joint project

联培项目



面向人群

- 2024级合肥工业大学微电子学院硕士研究生
- ★本科院校微全国知名高校，电子信息相关专业，成绩优异
- ★通过全国研究生入学统一考试（推免、保研学生优先
- ★通过合工大微电子学院和安芯电子面试
- ★原报考全日制的学生优先

安芯电子

- ★提供培养期间的各项福利待遇及综合保障
- ★安排公司资深专家指导，完成工程培养和毕业成果指导
- ★在校期间管理

联培学生

- ★自愿加入安芯电子合工大联培项目，签订培养及留用协议
- ★在校期间全脱产学习，遵守学校相关规章制度管理，完成学业目标
- ★在司期间全职工作，遵守公司相关规章制度，完成工作目标
- ★取得毕业证书学位证后，需继续在公司工作至少5年

微电子学院

- ★确保按照全日制培养模式培养，享受全日制的师资及学习资源
- ★安排学院专家导师指导，完成课程教学/学业学分/毕业论文辅导
- ★在校期间管理



联合培养学生的管理考核工作由学校和公司共同承担，同时通过学校和公司考核方可达到毕业要求

学校考核

- √ 遵守学校相关规章制度
- √ 在校期间的考勤
- √ 在校期间的学业成绩
- √ 文献阅读
- √ 学术交流
- √ 创新实践和助研工作实践
- √ 开题报告
- √ 中期答辩
- √ 毕业答辩

公司考核

- √ 遵守公司相关规章制度
- √ 公司试用期管理
- √ 在公司期间的考勤
- √ 在司期间的相关培训
- √ 工作目标达成
- √ 绩效考核
- √ 开题报告
- √ 中期答辩
- √ 毕业答辩

针对考核不达标学生，公司有权解除培养协议和劳动合同；
学生需按学校要求另行选择就业单位，学校继续培养。

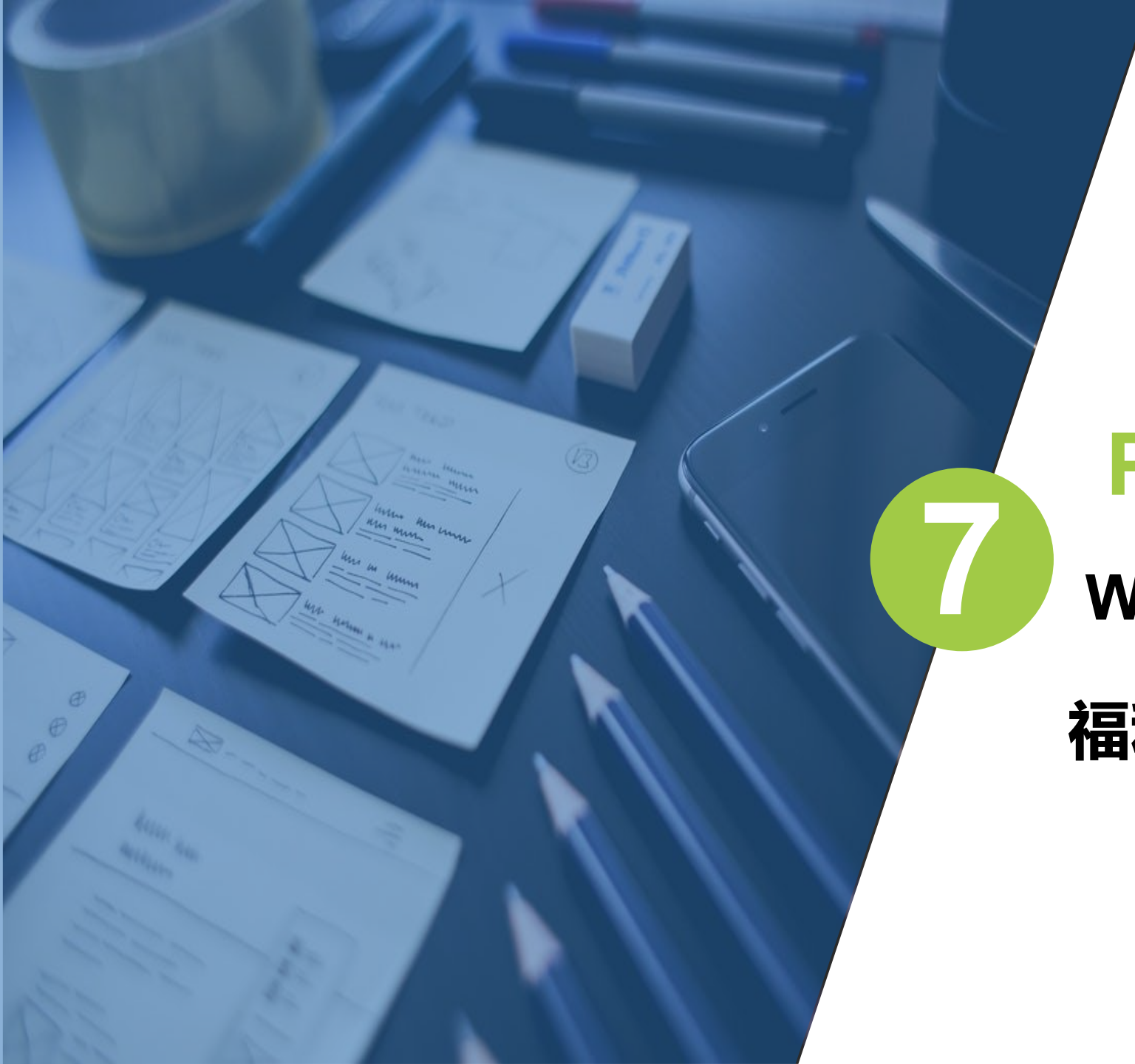


培养期间，如果有下述情况发生，须偿还公司已提供的全部联培费用（学费+在校阶段津贴）

- a. 选择放弃学习
- b. 即使完成了全部课程也没有取得最后的学业证书
- c. 在学习期间自愿退出或者因过错行为导致被辞退

※ 毕业后期间，如在已承诺的为公司工作的年限内，选择自愿离职或者因过错行为导致被辞退，须偿还公司已提供全部联培费用（学费+在校阶段津贴）的X%

已服务年限 偿还比率	(x%)
0-1	100%
1-2	80%
2-3	60%
3-4	40%
4-5	20%
》 5	0



7

PART7

Welfare

福利待遇



研一在司学习阶段

- 薪资5000元/月
- 缴纳五险一金
- 享受正式工福利待遇

研二研三在司阶段

- 薪资9000元/月
- 缴纳五险一金
- 享受正式工福利待遇
- 学费报销50%

毕业后阶段

- 薪资：按照当年校招标准
- 免试用期
- 年终奖金，完善的年度调薪机制
- 缴纳五险一金
- 享受正式工福利待遇
- 享受当地人才政策（房租补贴、购房补贴等）



同建和谐 实现共赢

联系我们



Add: 安徽省池州市金光大道88号

Tel: +86-0566-2220801

Tel: 18705667767 刘毅芳